

MEMS Test Handler

高达 20.000 UPH

产品特点

- 高产能及高稳定性
- 高达280个测试站
- 机台占地面积小 (900x1600mm)
- 可扩展并行测试的设计架构
- 动态三温测试
- 输入 / 输出转换快速
- 输入 / 输出设置载具：
Jedec Trays, Tape and Reel, Bowl, Tube, Wafer
- 采乒乓配置，提高系统吞吐量
- 具备追溯功能，完善纪录测试结果
- 符合 SECS / GEM 标准的操作介面



neoHANDLER
modula

传感器刺激源

麦克风和扬声器



磁性和电子指南针



加速度计和陀螺仪



环境传感器和物联网



Osai Automation Systems

功率器件封装测试解决方案

产品介绍

主要功能特色



PICK & PLACE

设备用于组装不同的功率模块，如：
芯片（dice）、导引框（lead frame）、
预成型件（preform）和塑料外壳（plastic case）。

- 适用于 Dice, Preform, AMB, Lead Frame, Plastic Case
- 输入配置载具: Tray, Blister, Tape & Reel, Bulk, Film Frame
- 高精度度: $\pm 5\mu\text{m}$
- 操作快速: Up to 1sec/cycle



PIN INSERTION

设备用于在基板上安装针脚，可适用于有线
针脚（插入式）和线圈针脚（在下一阶段进
行打孔和焊接）。

- 适用于有线针脚和线圈针脚
- 高精度度: $\pm 5\mu\text{m}$
- 针脚插入检测: Height $\pm 50\mu\text{m}$ / Force Control Up to 500N
- 操作快速: Up to 2pins/s
- 光学功能: 单针光学对准 / 3D扫描检测



DISPENSING / VACUUM POTTING

设备可配置胶水点胶功能，包括点胶喷嘴（具
有集成的光学检测和紫外线固化功能）或带有
真空灌封腔SiIGel点胶功能(包括两部分计量式
点胶器)。

- 适用于超快速喷射点胶 / 两组分计量点胶
- 设计用于助焊剂, 胶水和SiIGel
- 高精度度: $\pm 5\mu\text{m}$
- 光学功能: 紫外线照明视觉系统 / 高使用寿命的LED紫外线固化
- 操作快速: Up to 300PH
- 附加功能: 真空灌封腔 / 重量检测



SOLDERING / WELDING

根据连接方式，该设备可配置为真空感应焊
接或超声波焊接。

- 适用于导引框焊接 / 针脚焊接
- 高精度度: $\pm 5\mu\text{m}$
- 顶尖技术: 线性或扭转超声波焊接 / 具专利的真空感应焊接
- 光学功能: 完整的光学对准 / 高质量光学检测功能



LASER MARKING

设备用于对每个单独的导引框、AMB（先进
模块制造）和组件进行标记，以实现每个单
位的可追溯性。

绿色激光可在铜、银、陶瓷基板和塑料外壳
上进行快速准确标记。

- 绿色激光
- 依靠基准点检查以确保标记位置准确性
- 对1D / 2D码进行 100% 的数据和分级检查
- 光学检查以检测组件的存在与否
- 建置完整数据库（2D码、条形码、QR码等）
- 定制的通讯数据库，实现完善追溯功能



Automatic Line Example

Contact us

上海市浦东新区祖冲之路1077号2幢3201室
+86 (21) 6108 1858 #3121
marketing@spirox.com

